

MODSIM x AI Summit Japan 2026

MODSIM × AI で進化する設計・解析

— 3DEXPERIENCEが実現する高速・高度なものづくり—

開催のご案内

製品開発は、どこまで“試作レス”に近づけるのか。AIは、設計・解析の在り方をどう変えるのか。

新コンセプト「3D UNIV+RSES」の重要な柱であるAIは、
3DEXPERIENCE 2026よりプラットフォームの中核機能として本格的に搭載されました。

また、設計・開発領域のキーソリューションであるMODSIM（Modeling & Simulation）は、
機能進化とともにグローバルでの採用が急速に拡大しています。

本イベントは、MODSIMとAIの融合がもたらす新たな価値を、
日本の製造業における実際の課題解決にどう結びつけていくのかを、
お客様とともに深く掘り下げる、当社初の「MODSIM × AI」に特化したサミットです。

シミュレーション適用領域の拡大 / 試作レス開発 / 品質・試験問題による手戻り削減
人材不足やノウハウ継承

といった製造業が直面する課題に対し、3DEXPERIENCEプラットフォームを基盤とした
MODSIMとAIの活用による、設計・解析の高度化と高速化の可能性をご紹介します。

イベント概要

開催期間：2026年5月29日(金)10:00~17:30

参加方法：イベントウェブサイトより事前登録制 限定250名

会場：有明セントラルタワーホール & カンファレンス

構成：オンサイトイベント

基調講演、分科会セッション、製品展示、ネットワーキング会

対象：設計・解析/試験・製品開発に携わる方

ご参加方法

イベント登録

告知サイトは[こちら](#)です



登録開始は3月18日(水)を予定しています

※イベントの内容に関しては、変更の可能性があります

MODSIM x AI Summit Japan 2026

基調講演 講演ご紹介



ダッソー・システムズ株式会社
日本代表取締役社長
Philippe Godbout



Dassault Systèmes
Mechanical Industry
Process Consult
Mgt Senior Director,
CATIA Mechanical IPS
Daniel PYZAK



Dassault Systèmes
Industry Process Expert
Director, SIMULIA
Dhiraj NAHAR

分科会注目セッション

アシックス株式会社様
本田技研工業株式会社様

* その他多くのセッションをご用意しています

イベント構成

10:00-12:00
基調講演 (Keynote Plenary Session)

13:00-16:30
分科会A (Breakout sessions)
30分×5

13:00-16:30
分科会B (Breakout sessions)
30分×5

12:00-
展示 (Playground)

16:30-17:30
ネットワーキング会 Networking

講演などの詳細は、イベントウェブサイトからご確認いただけます

ご協賛企業

ダイヤモンドスポンサー



株式会社IDAJ



株式会社アルゴグラフィックス



プログレス・テクノロジーズ株式会社

サファイアスポンサー



藤松エレクトロニクス株式会社



株式会社ファソテック



株式会社ライトウェル

ロゴスポンサー



アイクアム/エム株式会社

